

1液または2液性の室温硬化型、熱硬化型、湿気吸収硬化型  
導電性エポキシ／シリコン接着&コーキング剤です。

## SHIELD COMPOUND

RoHS 対応品

### エポキシ系接着剤の特長

エポキシ系 CHO-BOND, 584-29, 584-208, 360-20 は、導電性の充填材を含んだエポキシ接着剤です。接着力に優れ、速乾性に優れています。

#### ● CHO-BOND 500 シリーズ

この銀充填材料は公差の厳しい接着ラインを要求される個所で使用されます。様々な硬化方法を利用でき、コーキング・ガンやへら、ニードル実装、シルクスクリーン法を使っての容易に実装できます。メッシュ・ガスケットの接着、プリント回路基板の補修、チップ・ボンディング、リア・ウィンドーの防霜装置の補修、低温下での柔軟な半田と同様に利用できます。

#### ● CHO-BOND 584-29

室温硬化・低粘度の2液性エポキシ接着剤で、はんだや溶接箇所にも使えます。使い易い 1.0/2.5/10 グラム単位のディスペンサー (CHO-PAK) から利用できます。

#### ● CHO-BOND 584-208

混合比 1:1 の2液性エポキシ接着剤で、24時間の室温硬化もしくは 100℃で45分間の加熱硬化により接着します。特に電気回路基板の修理用途に向いています。

#### ● CHO-BOND 300 シリーズ

この製品は公差の大きい表面へ接着するのに最適な大きな銀メッキ銅粒子 (> 50 ミクロン) を採用しています。接着層は 0.25mm 以上で接着可能です。砂のようなフィラーが酸化皮膜やアロジンコーティング (黄色) 等の薄い絶縁層を突き破り導通します。用途は鋳造アルミ筐体、コンジット隔壁の開口部、フィルター、キャビネットのシールドングや接着を含みます。注) 上記のコンパウンドは継ぎ目としての接着には使用しないでください。

#### ● CHO-BOND 360-20

混合比 1:1 の2液性エポキシ接着剤で、混合が容易でラップシアー接着強度が高いです。大きな隙間を埋めて優れた熱衝撃抵抗性を提供します。



### シリコン系接着剤の特長

シリコン系 CHO-BOND 1029, 1030, 1035, 1075 は、導電性の充填材を含んだシリコン接着剤です。各接着剤はそれぞれ様々な厚さで塗布でき、接着箇所は柔軟性が持たせられます。

#### ● CHO-BOND 1029

RoHS 対応品

2液性の高導電性接着剤で、導電性エラストマーと薄くプライマーを塗布した金属面との接着に適します。接着層は 0.2mm 以下で有効です。

#### ● CHO-BOND 1030

RoHS 対応品

1液性の高導電性 RTV (室温硬化型) 接着剤で、剥離強度に優れています。接着層は約 0.25mm 以下で有効です。適切な硬化の為、接着幅は 1.27cm 未満となります。

#### ● CHO-BOND 1035

RoHS 対応品

1液性の高導電性 RTV (室温硬化型) 接着剤／シーラント剤で、環境シールドと EMI シールドの両方の機能を発揮します。商用グレードの導電性ガスケットとエンクロージャーフランジとの接着に適しています。

#### ● CHO-BOND 1075

RoHS 対応品

1液性の高導電性接着剤／シーラント剤です。特にシールド・ラバー 2 及びシールド・シート 2 の 1285 材との相性が良く、電食の心配がありません。

#### ● プライマー 1086

RoHS 対応品

1030, 1038, 1075 用プライマー

※米国防衛装備品専用の接着剤のお取り扱いもございますので、最寄りの各営業所にお問い合わせください。

## 製品別特性〔エポキシ接着剤〕

型式	584-29	584-208	360-20
バインダー	エポキシ	エポキシ	エポキシ
フィラー	銀	銀	銀/銅
混合率	100:6.3	1:1	1:1
粘度状態	薄いペースト状	ペースト状	ペースト状
比重	2.5	2.6	5.0
最小ラップシアー 接着強度, psi (MPa)	1200 (8.28)	1000 (6.90)	1600 (11.04)
最小ダイシアー 接着強度, psi (MPa)	-	-	-
最大 DC 体積抵抗, Ω-cm	0.002	0.002	0.005
使用温度範囲	-55 ~ 125°C	-62 ~ 100°C	-62 ~ 100°C
接着条件, 加熱, 室温	15分@113°C 24時間	45分@100°C 24時間	15分@115°C 24時間
使用期限	0.5時間	1時間	1時間
保管期限, 月	12	9	9
塗布面積の目安 cm <sup>2</sup> /g	156.1	141.9	7.1
推奨塗布厚, mm	0.025 min.	0.025 min.	0.25 min.
揮発性有機化合物 VOC, g/liter	3	0	0
用途	基板の補修 ガスケットの接着	異種材料の接着	異種材料の接着

## 製品別特性〔シリコン接着剤〕

型式	1029	1030	1085	1086
バインダー	シリコン	シリコン	1029用 プライマー	1030, 1035, 1075用プライマー
フィラー	銀/銅	銀/銅		
混合率	1.0:2.5	1液性	1液性	1液性
粘度状態	厚いペースト状	砂状ペースト	液状	液状
比重	3.1	3.8	0.82	0.80
最小ラップシアー 接着強度, psi (MPa)	450 (3.11)	200 (1.38)	NA	NA
最大 DC 体積抵抗, Ω-cm	0.06	0.05	NA	NA
使用温度範囲	-55 ~ 125°C	-55 ~ 200°C	-80 ~ 200°C	-80 ~ 200°C
接着条件, 加熱, 室温	30分@121°C 1週間	NA 1週間	NA 30分	NA 30分
使用期限	2時間	30分	NA	NA
保管期限, 月	6*	6*	9	9
塗布面積の目安 cm <sup>2</sup> /g	25.5	18.5	NA	NA
推奨塗布厚, mm	0.20 max.	0.25 max.	0.00254 min. 0.01270 max	0.00254 min. 0.01270 max
揮発性有機化合物 VOC, g/liter	14	0	731	774
用途	EMI ガスケット接着	EMI ガスケット接着 標準品	プライマー	プライマー

※型式の末尾に-55が入った場合は、保管期限が9ヶ月となります。

## 接着剤用オーダーリスト

※在庫のご確認につきましては最寄りの各営業所にお問い合わせください。

製品	型式	サイズ	製品	型式	サイズ
CHO-BOND 584-29	50-10-0584-0029	1g CHO-PAK	CHO-BOND 1029	50-01-1029-0000	0.5kg
CHO-BOND 584-29	50-02-0584-0029	2.5g CHO-PAK	CHO-BOND 1029	50-00-1029-0000	85g
CHO-BOND 584-29	50-03-0584-0029	10g CHO-PAK			
CHO-BOND 584-29	50-01-0584-0029	0.5kg	CHO-BOND 1030	50-01-1030-0000	0.5kg
CHO-BOND 584-29	50-00-0584-0029	85g	CHO-BOND 1030	50-02-1030-0000	113g
CHO-BOND 584-208	50-01-0584-0208	0.5kg	プライマー		
CHO-BOND 584-208	50-00-0584-0208	85g	CHO-BOND 1085	50-01-1085-0000	0.47liter
			CHO-BOND 1086	50-01-1086-0000	0.47liter
CHO-BOND 360-20	50-01-0360-0020	0.5kg			

## 導電性コーキング剤およびシーラント剤

- CHO-BOND 1035 RoHS 対応品  
1液性の高導電性 RTV (室温硬化型) シーラント剤で、環境シールドと EMI シールドの両方の機能を発揮します。
- CHO-BOND 1038 RoHS 対応品  
1液性の高導電性 RTV シリコン接着剤/シーラント剤です。銀メッキ銅のフィラーが低い体積抵抗をもたらします。EMI シールドはもちろんのこと、環境シールドも実現できます。
- CHO-BOND 1075 RoHS 対応品  
1液性の高導電性接着剤/シーラント剤です。特にシールド・ラバー 2 及びシールド・シート 2 の 1285 材料との相性が良く、電食の心配がありません。

- CHO-BOND 4660, 4669  
非硬化タイプのコーキング剤で、EMI シールドの継ぎ目、パイプのネジ山などのコーキングに用います。コンジット、遮蔽隔壁、貫通フィッティング、アクセスパネルや仮組み構造物等に役立ちます。ポリイソブチレン系樹脂に導電材として銀を充填しています。4669 は細密な銀粒子で信頼性が高く、4660 は銀粒子が大きめで低価格です。

## 製品別特性

型式	1035	1038	1075	4660	4669	1086
バインダー	シリコン	シリコン	シリコン	ポリイソブチレン	ポリイソブチレン	1035,1038,1075 用プライマー
フィラー	銀/ガラス	銀/銅	銀/アルミ	銀/銅	銀/銅	
混合率	1液性	1液性	1液性	1液性	1液性	1液性
粘度状態	薄いペースト状	ペースト状	ペースト状	砂状ペースト	砂状ペースト	液状
比重	1.9	3.6	2.0	2.0	2.0	0.80
最小ラップシアー 接着強度, psi (MPa)	100 (0.69)	150 (1.03)	100 (0.69)	NA	NA	NA
最大 DC 体積抵抗, Ω-cm	0.05	0.01	0.01	0.08	0.08	NA
使用温度範囲	-55 ~ 200°C	-55 ~ 125°C	-55 ~ 200°C	-55 ~ 100°C	-55 ~ 100°C	-80 ~ 200°C
硬化条件	NA	NA	NA	NA	NA	NA
室温硬化時間	1週間	1週間	1週間	1週間	1週間	30分
使用期限	30分	30分	15分	30分	2.0時間	NA
保管期限, 月	6*	6*	6*	6	6	9
膨張性 cm <sup>2</sup> /g	21.3	10.6	17.0	12.8	12.8	NA
推奨塗布厚, mm	3.18 max.	3.18 max.	3.18 max.	3.18 max.	3.18 max.	0.00254 min. 0.01270 max.
VOC, g/liter	160	111	0	305	340	774
用途	広範な温度域	EMI + 環境シールド	シールドシート 1285 との相性良好	非硬化タイプ 小さなフィラー	非硬化タイプ フィラー大きめ	プライマー

※型式の末尾に-55が入った場合は、保管期限が9ヶ月となります。

## コーキング用オーダーリスト

※在庫のご確認につきましては最寄りの各営業所にお問い合わせください。

製品	型式	サイズ
CHO-BOND 1035	51-01-1035-0000	0.3kg kit
CHO-BOND 1035	51-00-1035-0000	71g kit
CHO-BOND 1038	50-01-1038-0000	0.5kg kit
CHO-BOND 1038	50-02-1038-0000	113g kit
CHO-BOND 1075	50-01-1075-0000	0.3kg kit
CHO-BOND 1075	50-02-1075-0000	71g kit
CHO-BOND 4660	51-05-4660-0000	0.7kg カートリッジ
CHO-BOND 4660	51-02-4660-0000	113g チューブ
CHO-BOND 4669	51-05-4669-0000	0.7kg カートリッジ
CHO-BOND 4669	51-02-4669-0000	113g チューブ
プライマー		
CHO-BOND 1086	50-01-1086-0000	0.47 liter